

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 7 février 2002 (07.02.2002)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 02/10779 A1

MESATRONIC [FR/FR]; ZAC de Champfeuillet, 130,

(51) Classification internationale des brevets7:

G01R 1/073

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/02411

(22) Date de dépôt international: 24 juillet 2001 (24.07.2001)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

00/09930

28 juillet 2000 (28.07.2000) FR

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): BEL-MONT, André [FR/FR]; Hameau Le Temple, F-38490 La Batie Divisin (FR). ROBERT, Laurent [FR/FR]; Clos Bérard Bate, 4, rue Brunetière, F-38500 Voiron (FR). AIT MANI, Abdel, Nacer [FR/FR]; 9, rue Gay, F-38400 Saint Martin d'Hères (FR).

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :

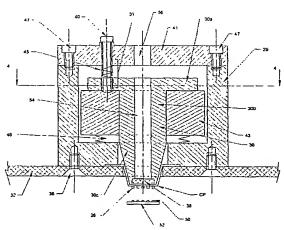
rue de Placyre, F-38500 Voiron (FR).

(74) Mandataire: HECKE, Gérard; Cabinet Hecke, WTC Europole, 5, place Robert Schuman, B.P. 1537, F-38025 Grenoble Cedex 1 (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR MAKING A CARD WITH MULTIPLE CONTACT TIPS FOR TESTING MICROSPHERE INTE-GRATED CIRCUITS, AND TESTING DEVICE USING SAID CARD

(54) Titre: PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CARTE A POINTES DE CONTACT MULTIPLE POUR LE TEST DE CIR-CUITS INTEGRES A MICROBILLES, ET DISPOSITIF DE TEST UTILISANT LA CARTE



(57) Abstract: The invention concerns a method for making a card with tips for testing semiconductor chips with microsphere bond pads. A first thin adhesive coat is vacuum deposited on a flexible polyimide film, followed by a second metal coat. A combination of UV photolithography and electroforming of a metal material enables to obtain the implantation of the tips (26). The pattern of the strip conductors is obtained by a second UV lithography operation whereby the second metal layer and the first adhesive coat are etched. An insulating protective resist is deposited on the active conductive zone. The flexible film (10) is mounted on a truncated maintaining component (30) whereof the vertical translational and planar rotational movements are made possible by a guide (43) supported on a spring suspension (46). The defective alignment between the plane of the tips (26) and the printed circuit plane (32) is corrected by a correcting system (31) with three support points adjustable with screws (40).

(57) Abrégé: L'invention concerne un procédé de fabrication d'une carte à pointes pour le test des puces semi-conductrices à plots de connexions du type microbilles. Une première couche mince d'accrochage est déposée sous vide sur un film souple de polyimide, suivie d'une deuxième couche métallique. Une combinaison de photolithographie UV

O 02/10779 A1

[Suite sur la page suivante]

WO 02/10779 A1



- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

et d'électroformage d'un matériau métallique permet d'obtenir l'implantation de pointes (26). Le tracé des pistes conductrices est obtenu par une deuxième opération de photolithographie UV par laquelle la deuxième couche métallique et la première couche d'accrochage sont gravées. Une épargne de protection isolante est déposée sur la zone active conductrice. Le film souple (10) est monté sur une pièce de maintien (30) tronquée dont les mouvements de translation verticale et rotation planaire sont rendus possibles par un guide (43) prenant appui sur une suspension à ressort (46) La correction du défaut de parallélisme, entre le plan des pointes (26) et le plan du circuit imprimé (32) est réalisée au moyen d'un système correcteur (31) à trois points d'appui réglables par vis (40).

Procédé de fabrication d'une carte à pointes de contact multiple pour le test de circuits intégrés à microbilles, et dispositif de test utilisant la carte.

5 Domaine technique de l'invention

L'invention est relative à une carte à pointes multiple destinée notamment à tester des puces semi-conductrices ayant des plots de connexion en forme de microbilles, ladite carte comprenant un substrat constitué par un film flexible isolant équipé de pistes conductrices connectées à des contacts en forme de pointes.

Etat de la technique

10

20

30

Il est connu de fabriquer des cartes de test à pointes sur des substrats souples en matière isolante, par exemple un film de polyimide, lequel sert à la fois de support aux pistes conductrices, et aux pointes.

Selon les documents US 5412866 et US 4980637, la membrane souple présente une forme convexe, et un matelas en élastomère est agencé à l'arrière de la membrane de manière à obtenir une planéité des extrémités des pointes.

Selon le document US 5914613, les contacts de la carte sont montés sur des poutrelles rigides connectées électriquement à des conducteurs flexibles. Un matelas en élastomère se trouve également à l'arrière de la membrane souple.

Dans le dispositif décrit dans le document EP 259163, un film de polyimide est découpé et conformé selon une tête pyramidale tronquée. Des plaques élastiques en plastique se trouvent entre le film et un support fixe pour contrôler la pression de contact des pointes sur les plots de connexion de la puce à tester.

Le document WO 98/45716 décrit un procédé de fabrication d'une carte de test, dont les pointes sont réalisées par électroformage sur un substrat rigide, par exemple en AsGA, quartz ou verre. Un tel procédé permet d'obtenir dans la zone de contact, une répartition des pointes avec une haute densité et un pas fin.

Objet de l'invention

10

15

5

Un premier objet de l'invention consiste à réaliser une carte de test sur un substrat souple isolant servant à la fois d'amortisseur et de support aux pistes conductrices et aux pointes, et permettant d'obtenir une déformation suffisante pour répartir uniformément la pression de contact des pointes sur les plots de connexion de la puce, avec un effort vertical pur sans frottement.

Le deuxième objet de l'invention consiste à réaliser une correction fiable du défaut de parallélisme, entre le plan des pointes de test et son circuit imprimé support.

20

30

Un procédé de fabrication d'une carte à pointes multiple selon l'invention est caractérisé par les étapes suivantes :

- une première couche métallique d'accrochage de faible épaisseur est déposée sur le film souple en matière isolante,
- une deuxième couche métallique est déposée sous vide ou par électrolyse sur la première couche d'accrochage pour constituer le matériau des futures pistes conductrices,
 - on réalise les pointes métalliques par une combinaison d'une première opération de photolithographie UV faisant usage d'une résine photosensible épaisse, et d'un électroformage au moyen d'un électrolyte à ions métalliques,

- on effectue une gravure sélective de la deuxième couche métallique et de la première couche d'accrochage à l'aide d'une deuxième opération de photolithographie UV pour obtenir les pistes conductrices,
- et on dépose une couche isolante superficielle de passivation sur la zone active conductrice.

5

10

15

20

25

30

Le film flexible du substrat est un polymère, notamment un polyimide, ayant une épaisseur supérieure à 25 microns. Une telle épaisseur permet d'obtenir la déformation souhaitée, et de supporter une forte densité de pointes. La première couche métallique d'accrochage est à base de chrome ou de nickel, tandis que la deuxième couche métallique peut être en cuivre, en or, ou en aluminium.

Selon une caractéristique de l'invention, le film souple est monté sur une partie tronquée d'une pièce de maintien coopérant avec un guide associé à une suspension à ressort, de manière à obtenir une répartition uniforme de la pression de contact des pointes sur la totalité des plots de connexion sans frottement latéral. Les pointes obtenues par électroformage peuvent présenter des surfaces de contact planes, concaves ou convexes. La correction du défaut de parallélisme entre le plan du circuit imprimé support et le plan des pointes est opérée au moyen d'un système correcteur à trois points d'appui réglables par vis agissant sur l'embase de la pièce de maintien.

Selon un mode de réalisation préférentiel, la pièce de maintien comprend une partie intermédiaire cylindrique agencée coaxialement à l'intérieur du guide, et ayant un diamètre inférieur à celui de l'embase. La partie tronquée de la pièce de maintien est dotée d'une fenêtre munie d'une plaquette en matériau transparent, en verre ou en quartz, autorisant un test visuel de l'alignement des pointes sur les plots de connexion de la puce semi-conductrice.

Description des figures

5

30

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre d'un mode de réalisation de l'invention donné à titre d'exemple non limitatif, et représenté aux dessins annexés, dans lesquels:

- la figure 1 montre les différentes étapes a-f du procédé de fabrication de la carte à pointes sur substrat flexible selon l'invention ;
- les figures 2A, 2B, 2C représentent différentes formes de surfaces des
 pointes de la carte selon l'invention;
 - la figure 3 est une vue en coupe transversale de l'assemblage de test complet;
 - la figure 4 est une vue en coupe longitudinale selon la ligne 4-4 de la figure
 3 au niveau de la fonction de réglage;
- la figure 5 représente une vue en plan de la carte illustrée à l'étape f de la figure 1;
 - la figure 6 est une vue de dessous de la figure 3.

20 Description d'un mode de réalisation préférentiel

La figure 1 illustre les étapes technologiques mises en œuvre pour fabriquer la carte à pointes CP sur un substrat souple déformable.

25 <u>Etape a</u>: on utilise comme substrat 10 un film souple en matière isolante, par exemple de polyimide, ayant une épaisseur de l'ordre de 25 microns.

Etape b : une première couche métallique 20 d'accrochage, notamment à base de chrome ou de nickel, est déposée sur toute la surface du substrat 10 isolant. Le dépôt de la couche 20 s'effectue par évaporation sous vide ou par pulvérisation cathodique. Dans l'exemple illustré à la figure 1, la face de travail est la face supérieure, mais on peut concevoir de travailler sur les deux faces.

Etape c : une deuxième couche métallique 22, constitutive des futures pistes conductrices de la carte, est ensuite déposée sur la couche 20 d'accrochage. La deuxième couche 22 peut être en cuivre, en or ou en aluminium, et est déposée soit en couche mince sous vide, ou soit plus épaisse, par électrolyse par exemple.

Etape d: on réalise une première opération de photolithographie UV après avoir déposé sur la deuxième couche métallique 22 une épaisse couche de résine photosensible, laquelle est révélée après avoir été insolée au travers d'un masque comportant le dessin des pointes. L'opération de photolithographie est suivie par une opération d'électroformage consistant à fabriquer les pointes 26 sous la forme de plots métalliques par l'utilisation d'un électrolyte.

15

25

30

10

5

<u>Etape e</u>: une deuxième opération de photolithographie UV permet de graver la deuxième couche métallique 22 et la première couche d'accrochage 20 suivant le tracé des pistes voulu et la forme des pointes 26 réalisées.

20 Il est clair que l'ordre de succession des étapes d et e peut être inversé.

<u>Etape f</u>: on dépose une couche isolante 24 de passivation sur la zone active conductrice. La couche 24 est composée d'un oxyde ou d'un polymère en couche mince déposée localement, et sert à protéger les pistes conductrices, en réduisant les problèmes liés à l'encrassement des pointes lors du test. La figure 5 montre la vue en plan de la carte CP en fin de fabrication.

En référence aux figures 2A, 2B, 2C, la surface supérieure 27 des pointes 26 électrodéposées, venant au contact des microbilles à tester, peuvent avoir différentes formes afin de ne pas endommager les microbilles. Sur la figure 2A, la surface supérieure 27 est plane. Sur la figure 2B, la surface supérieure 27 est

WO 02/10779 PCT/FR01/02411 6

concave pour épouser la forme complémentaire de la microbille. Sur la figure 2C, la surface supérieure 27 est bombée selon un profil convexe.

Sur les figures 3, 4 et 6, le substrat 10 souple est monté sur un dispositif support 29, lequel est équipé d'un système correcteur 31 de défaut de parallélisme utilisant des moyens d'appui réglables en trois points.

10

15

20

25

30

Le substrat 10 souple est fixé sur une pièce de maintien 30 centrale destinée à se déplacer coaxialement dans un guide 43. La pièce de maintien 30 comporte une embase 30a, une partie intermédiaire 30b cylindrique agencée coaxialement à l'intérieur du guide 29 annulaire, et une partie tronquée 30c sur laquelle est adaptée le substrat 10 flexible. Le contact électrique entre les pistes conductrices de la carte 10 et le circuit imprimé 32 est assuré par appui au moyen de vis 36 d'assemblage vissées dans le support 29. Le mouvement relatif de la pièce 30 mobile dans le guide 43 s'opère en translation verticale ou en rotation autour de l'axe vertical .

Le défaut de parallélisme entre le plan des pointes 26 et le circuit imprimé 32 est corrigé par le système correcteur 31 au moyen de trois vis 40 de réglage décalées angulairement à 120 degrés. Les vis 40 traversent le couvercle 41, et des premiers ressorts 45 sont intercalés entre la face inférieure du couvercle 41 et l'embase 30a circulaire, laquelle prend appui sur la face supérieure du guide 43. Un deuxième ressort 46 est agencé dans l'intervalle opposé ménagé entre la face inférieure du guide 43 et le dispositif support 29. Le couvercle 41 est monté sur le support 29 par des vis 47, et l'embase 30a présente un diamètre supérieur à celui de partie intermédiaire 30b de la pièce 30.

L'alignement des pointes 26 sur les plots de connexion 50 de la puce 52 semiconductrice à tester, est visuel et s'effectue au moyen d'une fenêtre 38 dotée d'une plaquette en matériau transparent, en verre ou en quartz, laquelle est

disposée en regard d'ouvertures 54, 56 alignées coaxialement dans la pièce tronquée 30 et le couvercle 41.

Le contact des pointes 26 avec les plots de connexion 50 de la puce 52 s'opère sans frottement latéral notable de manière à éviter l'usure des plots. La flexibilité du film souple du substrat 10 sert d'une part d'amortisseur absorbant les efforts de compression pendant l'opération de test, et d'autre part de répartiteur de la pression de contact sur la totalité des plots de connexion 50 sphériques de la puce 52.

5

10

REVENDICATIONS

5

10

15

20

25

30

- 1. Procédé de fabrication d'une carte à pointes multiple destinée notamment à tester des puces semi-conductrices ayant des plots de connexion en forme de microbilles, ladite carte comprenant un substrat (10) constitué par un film flexible isolant équipé de pistes conductrices connectées à des contacts en forme de pointes (26), ledit procédé étant caractérisé par les étapes suivantes :
 - une première couche métallique (20) d'accrochage de faible épaisseur est déposée sur le film souple en matière isolante,
 - une deuxième couche métallique (22) est déposée sous vide ou par électrolyse sur la première couche (20) d'accrochage pour constituer le matériau des futures pistes conductrices,
 - on réalise les pointes (26) métalliques par une combinaison d'une première opération de photolithographie UV faisant usage d'une résine photosensible épaisse, et d'un électroformage au moyen d'un électrolyte à ions métalliques,
 - on effectue une gravure sélective de la deuxième couche métallique (22) et de la première couche (20) d'accrochage à l'aide d'une deuxième opération de photolithographie UV pour obtenir les pistes conductrices,
 - et on dépose une couche isolante (24) superficielle de passivation sur la zone active conductrice.
- 2. Procédé de fabrication d'une carte à pointes selon la revendication 1, caractérisé en ce que le film flexible du substrat (10) est un polymère, notamment un polyimide, ayant une épaisseur supérieure à 25 microns.

- 3. Procédé de fabrication d'une carte à pointes selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première couche métallique (20) d'accrochage est à base de chrome ou de nickel.
- 4. Procédé de fabrication d'une carte à pointes selon la revendication 1, caractérisé en ce que la deuxième couche métallique (22) peut être en cuivre, en or, ou en aluminium.
- 5. Procédé de fabrication d'une carte à pointes selon la revendication 1, caractérisé en ce que les pointes (26) obtenues par électroformage présentent des surfaces de contact planes, concaves ou convexes.
 - 6. Carte à pointe multiple obtenue selon le procédé de l'une des revendications 1 à 5.

15

20

25

- 7. Carte à pointe multiple pour mesurer les caractéristiques électriques d'une puce (52) semi-conductrice ayant des plots de connexion (50) en forme de microbilles, ladite carte (CP) comprenant un substrat (10) formé par un film flexible isolant équipé de pistes conductrices connectées électriquement à des contacts en pointes (26) destinés à venir en engagement avec lesdits plots de connexion (50) lors du test,
- caractérisée en ce que le film souple est monté sur une partie tronquée (30c) d'une pièce de maintien (30) coopérant avec un guide (43) associé à une suspension à ressort (46), de manière à obtenir une répartition uniforme de la pression de contact des pointes (26) sur la totalité des plots de connexion (50) sans frottement latéral, et que la correction du défaut de parallélisme entre le plan du circuit imprimé (32) support et le plan des pointes (26) est opérée au moyen d'un système correcteur (31) à trois points d'appui réglables par vis (40) agissant sur l'embase (30a) de la pièce de maintien (30).

30

8. Carte à pointe multiple selon la revendication 7, caractérisée en ce que la pièce de maintien (30) comprend une partie intermédiaire (30b) cylindrique

agencée coaxialement à l'intérieur du guide (29), et ayant un diamètre inférieur à celui de l'embase (30a).

9. Carte à pointe multiple selon l'une des revendications 7 ou 8 caractérisée en ce que la partie tronquée (30c) de la pièce de maintien (30) est dotée d'une fenêtre (38) munie d'une plaquette en matériau transparent, en verre ou en quartz, autorisant un test visuel de l'alignement des pointes (26) sur les plots de connexion (50) de la puce (52) semi-conductrice.

5

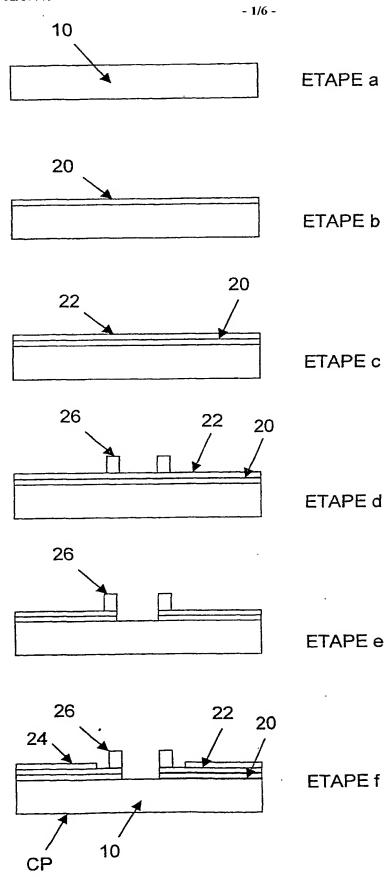
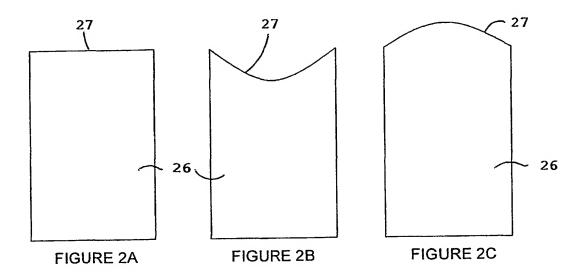
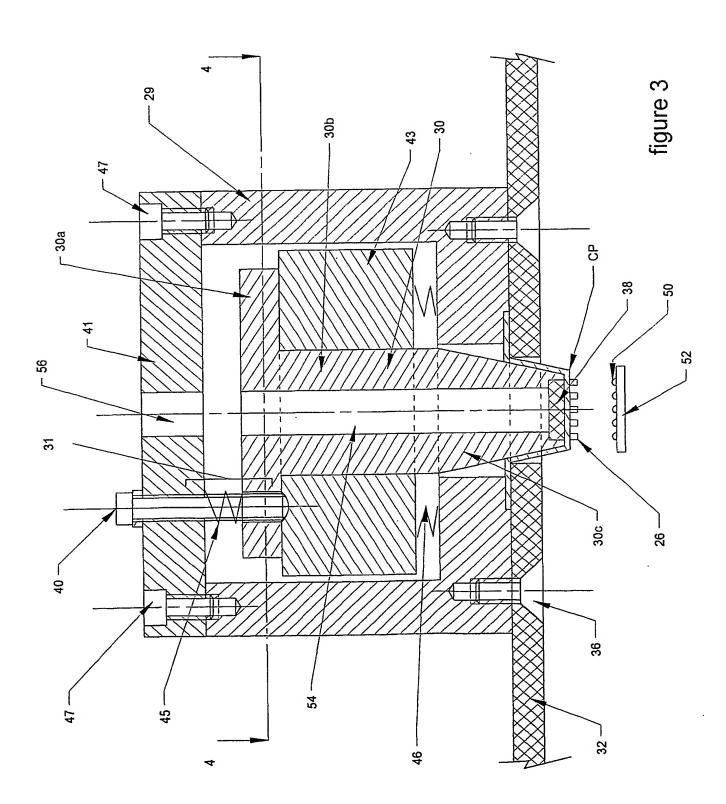


FIGURE 1

		•



			•
	•		
			4



	9	
		•
		•
		^

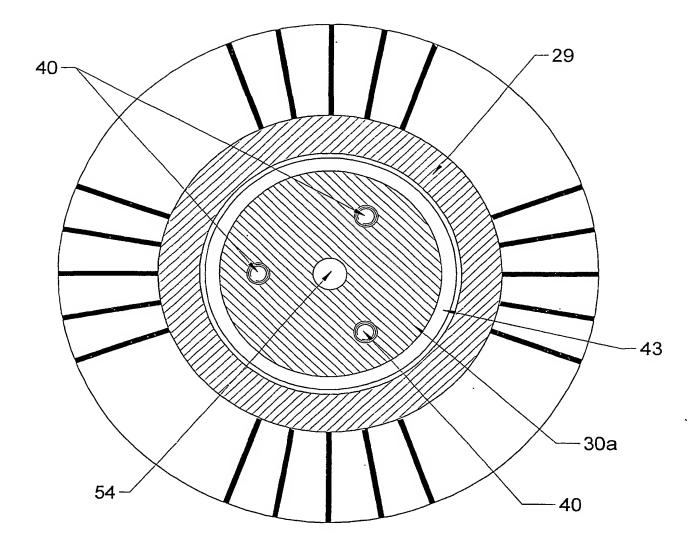


Figure 4

•,		•
		,

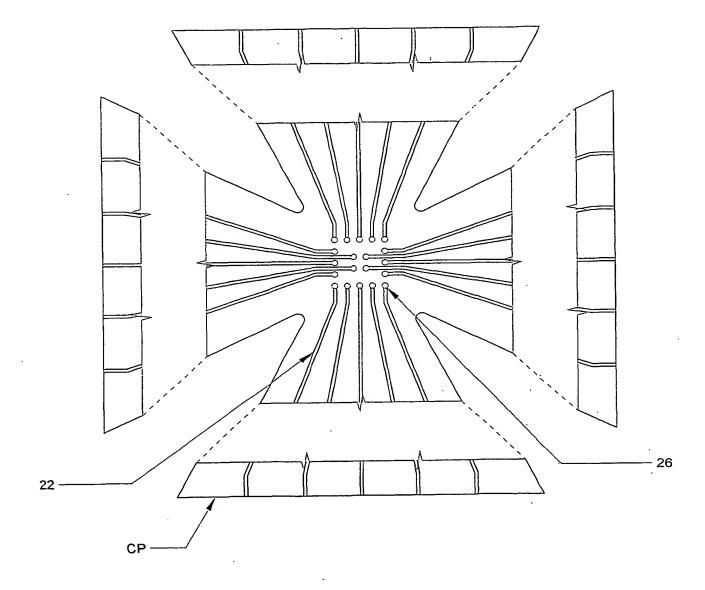
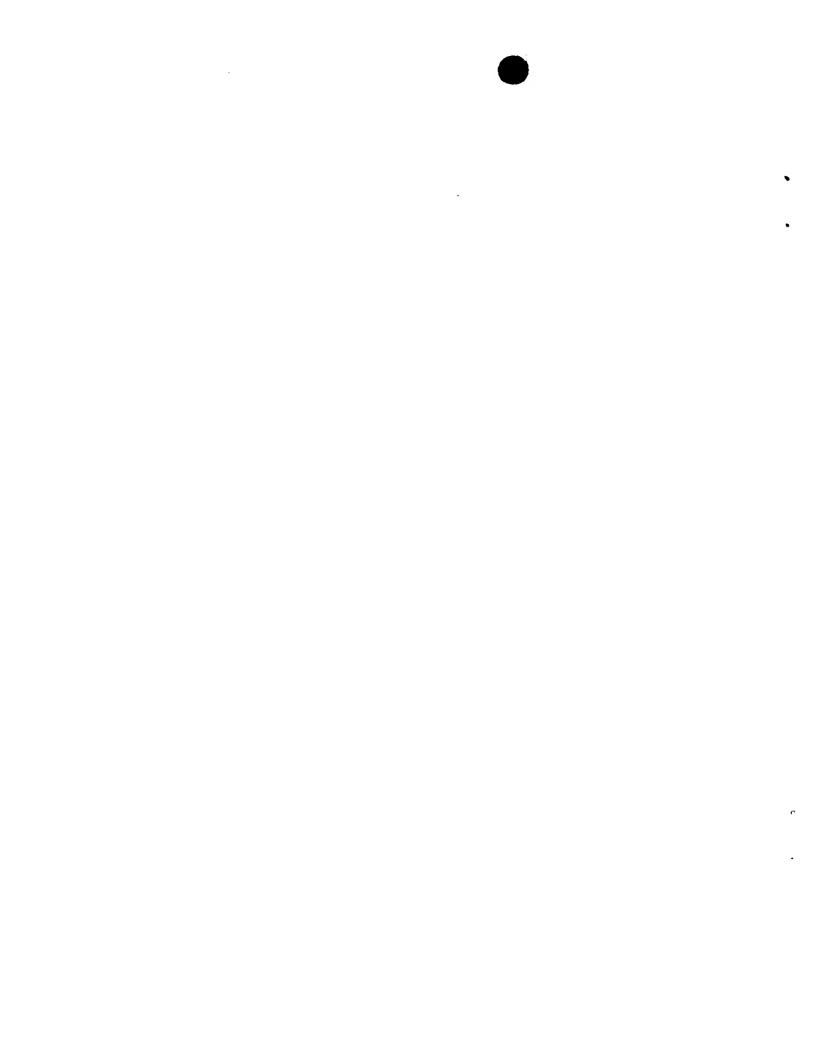


Figure 5



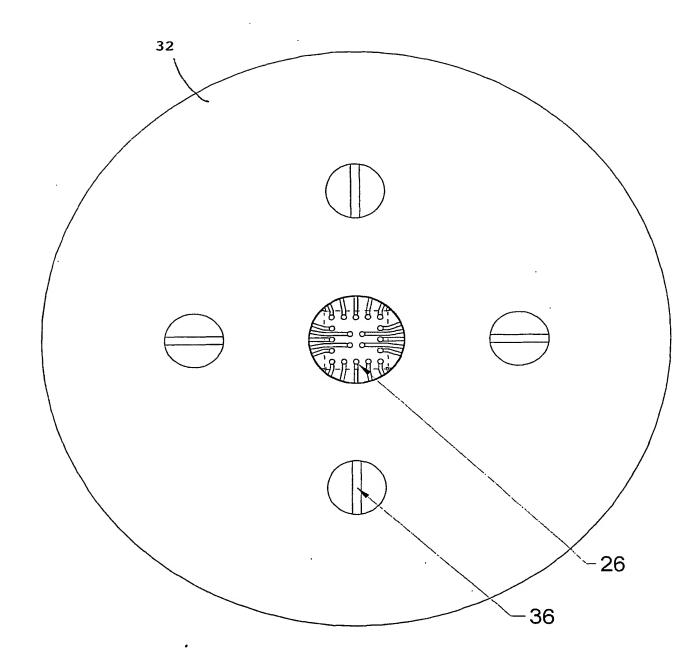
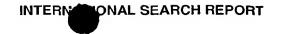


FIGURE 6

		٠
		,



Intern Application No PCT/FR 01/02411

IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01R1/073				
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC			
	Deamontation searched (classification system followed by classification	on symbols)			
IPC 7	G01R	,			
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields so	earched		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used	1)		
EPO-In	ternal				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.		
А	EP 0 999 451 A (NITTO DENKO) 10 May 2000 (2000-05-10) abstract; figures 4,8A-9E		1,7		
А	WO 98 52218 A (HITACHI) 19 November 1998 (1998-11-19) abstract; figures 7,8		7		
А	WO 98 45716 A (MESATRONIC) 15 October 1998 (1998-10-15) cited in the application abstract; figure 12		1		
А	EP 0 772 049 A (NITTO DENKO) 7 May 1997 (1997-05-07) column 4, line 11 -column 5, line column 8, line 47 -column 9, line figures 1A-2C		1		
		- /			
X Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.		
"A" docume	tegories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	'T' later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but		
"E" earlier of filing d	document but published on or after the international late	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot			
 L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the 					
other r	ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ant published prior to the international filing date but	document is combined with one or mo ments, such combination being obvior in the art.			
later th	nan the priority date claimed	*&* document member of the same patent	<u> </u>		
	actual completion of the internalional search	Date of mailing of the international sea	arch report		
1	9 December 2001	28/12/2001			
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL ~ 2280 HV Rijswijk	Authorized officer			
	Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Iwansson, K			

TERNATIONAL SEARCH REPORT

International	Application No
PCT/FR	01/02411

a .a		rci/rk 01	,
Category °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
	or a property of the state of t		- Individual to Section 1
A	KONDOH Y ET AL: "UNIVERSAL MEMBRANE PROBE FOR KNOWN GOOD DIE" INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROCIRCUITS AND ELECTRONIC PACKAGING, US, INTERNATIONAL MICROELECTRONICS & PACKAGING SOCIETY, vol. 17, no. 4, 1 October 1994 (1994-10-01), pages 323-329, XP000497394 ISSN: 1063-1674		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nform on patent family members

Intern Application No
PCT/FR 01/02411

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 999451	A	10-05-2000	JP EP TW	2000150594 A 0999451 A2 439166 B	30-05-2000 10-05-2000 07-06-2001
WO 9852218	Α	19-11-1998	JP WO US	11023615 A 9852218 A1 6305230 B1	29-01-1999 19-11-1998 23-10-2001
WO 9845716	A	15-10-1998	FR AT CN DE EP WO US	2762140 A1 204650 T 1252129 T 69801429 D1 0975979 A1 9845716 A1 6289583 B1	16-10-1998 15-09-2001 03-05-2000 27-09-2001 02-02-2000 15-10-1998 18-09-2001
EP 772049	A	07-05-1997	JP JP EP US	3096234 B2 9127157 A 0772049 A2 5848465 A	10-10-2000 16-05-1997 07-05-1997 15-12-1998

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G01R1/073

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CTB 7 G01R

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relevent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Α	EP 0 999 451 A (NITTO DENKO) 10 mai 2000 (2000-05-10) abrégé; figures 4,8A-9E	1,7
A	WO 98 52218 A (HITACHI) 19 novembre 1998 (1998-11-19) abrégé; figures 7,8	7
Α	WO 98 45716 A (MESATRONIC) 15 octobre 1998 (1998–10–15) cité dans la demande abrégé; figure 12	1
Α	EP 0 772 049 A (NITTO DENKO) 7 mai 1997 (1997-05-07) colonne 4, ligne 11 -colonne 5, ligne 14 colonne 8, ligne 47 -colonne 9, ligne 28; figures 1A-2C -/	1

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mals publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de public de d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle "Indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à gage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mals	T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention X* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément Y* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier &* document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
19 décembre 2001	28/12/2001
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autorisé
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Iwansson, K



Demail Prinationale No
PCT/rk 01/02411

		PCI/PR UI	, 01 111
C.(suite) De Catégorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec,le cas échéant, l'indicationdes passages p	ertinents	no. des revendications visées
Categorie	identification des documents cités, avecție das concart, i maistantes perses p		
	KONDOH Y ET AL: "UNIVERSAL MEMBRANE PROBE FOR KNOWN GOOD DIE" INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROCIRCUITS AND ELECTRONIC PACKAGING, US, INTERNATIONAL MICROELECTRONICS & PACKAGING SOCIETY, vol. 17, no. 4, 1 octobre 1994 (1994-10-01), pages 323-329, XP000497394 ISSN: 1063-1674		
	·		
	·		

RAPPORT DECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements re

ux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/FR 01/02411

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 999451	A	10-05-2000	JP EP TW	2000150594 A 0999451 A2 439166 B	30-05-2000 10-05-2000 07-06-2001
WO 9852218	A	19-11-1998	JP WO US	11023615 A 9852218 A1 6305230 B1	29-01-1999 19-11-1998 23-10-2001
WO 9845716	A	15–10–1998	FR AT CN DE EP WO US	2762140 A1 204650 T 1252129 T 69801429 D1 0975979 A1 9845716 A1 6289583 B1	16-10-1998 15-09-2001 03-05-2000 27-09-2001 02-02-2000 15-10-1998 18-09-2001
EP 772049	Α	07-05-1997	JP JP EP US	3096234 B2 9127157 A 0772049 A2 5848465 A	10-10-2000 16-05-1997 07-05-1997 15-12-1998

PCT

For receiving Office use only
International Application No.
International Filing Date
Name of receiving Office and "PCT International Application"
Applicant's or agent's file reference

REQUEST	International Filing Date					
The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"					
	Applicant's or agent's file r	reference				
	(if desired) (12 characters max					
Box No. I TITLE OF INVENTION METHOD FOR MAKING A CARD WITH MULTIPLE CONT CIRCUITS, AND TESTING DEVICE USING SAID CARD	ACT TIPS FOR TESTING N	MICROSPHERE INTEGRATED				
Box No. II APPLICANT	This person is also invento	or				
Name and address: (Family name followed by given name; for a leg The address must include postal code and name of country. The count Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of MESATRONIC 130 rue de Placyre,	ry of the address indicated in the					
ZAC de Champfeuillet 38500 VOIRON (FR)		Teleprinter No.				
		Applicant's registration No. with the Office				
State (that is, country) of nationality: FRANCE	State (that is, country) of r	residence: FRANCE				
	• []	United States America only the States indicated in the Supplemental Box				
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FU	RTHER) INVENTOR(S))				
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) BELMONT Andre Hameau le Temple 38490 La Batie Divisin (FR) FRANCE This person is: applicant only inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) Applicant's registration No. with the Office						
State (that is, country) of nationality: FRANCE	State (that is, country) of resid	idence: FRANCE				
This person is applicant for all designated all designated	. 1371	United States America only the States indicated in the Supplemental Box				
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.						
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE						
The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of applicant(s) before the competent International Authorities as:	of the agent	common representative				
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.) Telephone No. +33 4 76 84 95 45						
HECKE Gerard Cabinet HECKE WTC Europole, 5 Place Robert Schuman BP 1537 F-38025 GRENOBLE Cedex 1 FRANCE		Facsimile No. +33 4 76 84 95 48 Teleprinter No.				
	Agent's registration No. with the Office					
Address for correspondence: Mark this check-box where no a instead to indicate a special address to which correspondence should be a special address to the special address		s/has been appointed and the space above is used				

	j	•

Continuation of Box No. III FURTE APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) II TOR(S)						
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.						
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) ROBERT Laurent Clos Berard Bate 4 rue Brunetiere 38500 VOIRON (FR)	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) Applicant's registration No. with the Office					
State (that is, country) of nationality: FRANCE State (that is, country) of res	FRANCE					
	nited States the States indicated in the Supplemental Box					
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) AIT MANI Abdel Nacer 9 rue Gay 38400 Saint Martin d'Heres (FR)	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) Applicant's registration No. with the Office					
State (that is, country) of nationality: FRANCE State (that is, country) of res	idence: FRANCE					
This person is applicant for all designated all designated States except the U	nited States the States indicated in the Supplemental Box					
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) Applicant's registration No. with the Office						
State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of res	idence:					
	nited States the States indicated in the Supplemental Box					
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) Applicant's registration No. with the Office						
State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence:						
	nited States the States indicated in the Supplemental Box					
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.						

	•	,
•		

Mark the applicable check-boxes be at least one must be marked.

The following designations are hereby made under Rule 4.9(a): (Double-click here if you want all the boxes below checked.)

Regional Patent

- AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT
- EA Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT
- EP European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH & LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, TR Turkey, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT

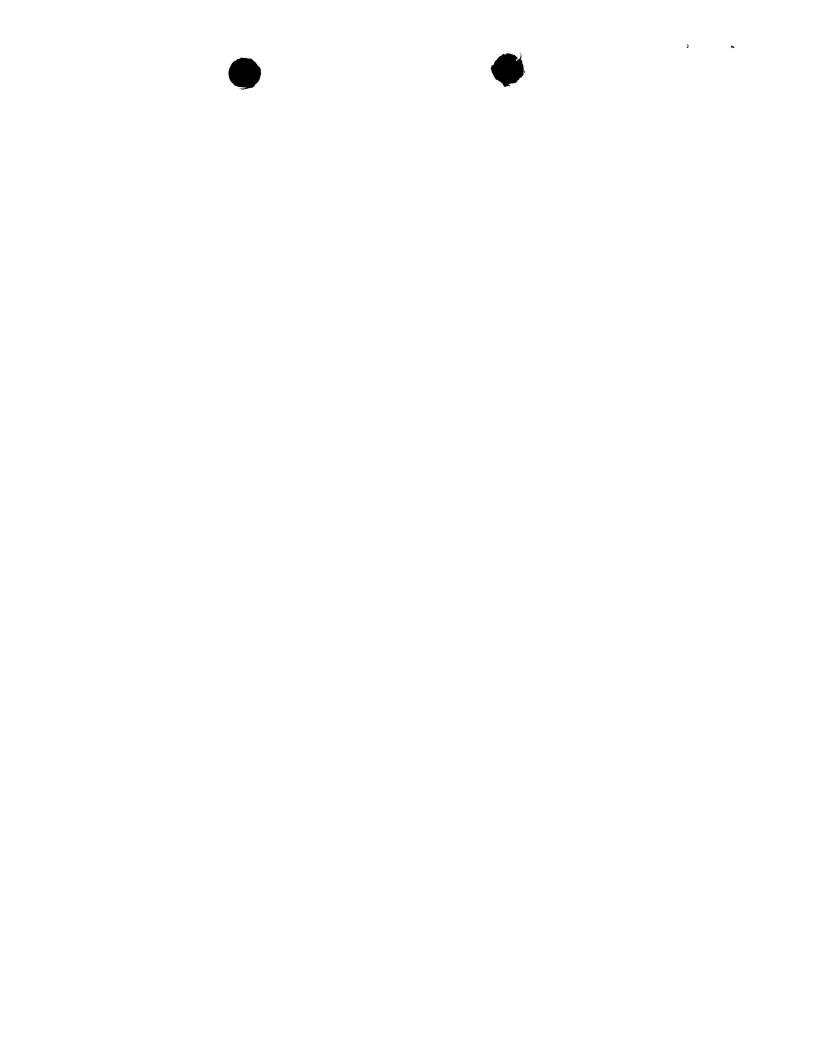
National Patent (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line):

\boxtimes	AE	United Arab Emirates	\boxtimes	GE	Georgia	\boxtimes	MW	Malawi
\boxtimes	\mathbf{AG}	Antigua and Barbuda	\boxtimes	GH	Ghana	\boxtimes	MX	Mexico
\boxtimes	AL	Albania	\boxtimes	GM	Gambia	\boxtimes	MZ	Mozambique
\boxtimes	AM	Armenia	\boxtimes	HR	Croatia	\boxtimes	NO	Norway
\boxtimes	AT	Austria	\boxtimes	HU	Hungary	\boxtimes	NZ	New Zealand
\boxtimes	ΑU	Australia	\boxtimes	ID	Indonesia	$\overline{\boxtimes}$	PL	Poland
\boxtimes	ΑZ	Azerbaijan	\boxtimes	IL	Israel	\boxtimes	PT	Portugal
\boxtimes	BA	Bosnia and Herzegovina	\boxtimes	IN	India	\boxtimes	RO	Romania
			\boxtimes	IS	Iceland	\boxtimes	RU	Russian Federation
\boxtimes	BB	Barbados	\boxtimes	JP	Japan			
\boxtimes	BG	Bulgaria	\boxtimes	KE	Kenya	\boxtimes	SD	Sudan
\boxtimes	BR	Brazil	\boxtimes	KG	Kyrgyzstan	\boxtimes	SE	Sweden
\boxtimes	BY	Belarus	\boxtimes	KP	Democratic People's	\boxtimes	SG	Singapore
Ø	BZ	Belize			Republic of Korea	×	SI	Slovenia
	CA	Canada	\boxtimes	KR	Republic of Korea	\boxtimes	SK	Slovakia
\boxtimes	CH 8	LI Switzerland and Liechtenstein	\boxtimes	KZ	Kazakhstan	\boxtimes	SL	Sierra Leone
\boxtimes	CN	China	\boxtimes	LC	Saint Lucia	\boxtimes	TJ	Tajikistan
	CO	Colombia	\boxtimes	LK	Sri Lanka	\boxtimes	TM	Turkmenistan
\boxtimes	CR	Costa Rica	\boxtimes	LR	Liberia	\boxtimes	TR	Turkey
\boxtimes	CU	Cuba	\boxtimes	LS	Lesotho	\boxtimes	TT	Trinidad and Tobago
	\mathbf{CZ}	Czech Republic	\boxtimes	LT	Lithuania			
\boxtimes	DE	Germany	\boxtimes	LU	Luxembourg	\boxtimes	TZ	United Republic of Tanzania
\boxtimes	DK	Denmark	\boxtimes	LV	Latvia	\boxtimes	UA	Ukraine
	DM	Dominica	\boxtimes	MA	Morocco	\boxtimes	UG	Uganda
\boxtimes	DZ	Algeria	\boxtimes	MD	Republic of Moldova	\boxtimes	US	United States of America
\boxtimes	EE	Estonia						
\boxtimes	ES	Spain	\boxtimes		Madagascar	\boxtimes	UZ	Uzbekistan
\boxtimes	FI	Finland	\boxtimes	MK	The former Yugoslav	\boxtimes	VN	Viet Nam
	GB	United Kingdom			Republic of Macedonia	\boxtimes	YU	Yugoslavia
\boxtimes	GD	Grenada				\boxtimes	ZA	South Africa
			\boxtimes	MN	Mongolia	\boxtimes	ZW	Zimbabwe
heck	Check-boxes reserved for designating States which have become party to the PCT after issuance of this sheet							
	Areck-boxes reserved for designating states which have become party to the PC1 after issuance of this sheet							
□.							•••••	••••••
		••••••						

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except the designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees) must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

	•

Box No. VI PRIORI	TY CLAIM				
The priority of the foll	owing earlier application	on(s) is hereby claimed:			
Filing date	Number		Where earlier application	is	
of earlier application	of earlier application	national application:	regional application:*	international application:	
	of earlier application		, ,	receiving Office	
(day/month/year)		country	regional Office	receiving Office	
item (1) 28/07/2000	00 09930	FRANCE			
28 July 2000			 		
item (2)					
item (3)					
		<u> </u>			
item (4)					
item (5)					
nem (3)					
Further priority cl	aims are indicated in the	Supplemental Box.			
Th			1.D	shtititi(a)	
(only if the earlier applied Office) identified above a	cation was filed with the	ransmit to the Internations Office which for the purp	al Bureau a certified copy of tooses of this international app	the earlier application(s) lication is the receiving	
-33 ,					
all items it	tem item	item	item item	other, see	
	(2)	(3)		Supplemental	
(1)	(2)	(3)	, (3)	Box	
			y party to the Paris Convention for		
Industrial Property or one I	Member of the World Trade (Organization for which that e	arlier application was filed (Rule	e 4.10(b)(ii)):	
Box No. VII INTERNA	ATIONAL SEARCHING	G AUTHORITY			
Chaice of International	l Secreting Authority (ISA) (if two or more Inter	national Sagrahina Authoritian	are compatent to carry out the	
	_	two-letter code may be used)		are competent to carry out the	
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
15A /	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		
Request to use results of e Searching Authority):	arlier search: reference to	that search (if an earlier se	arch has been carried out by or	requested from the International	
Date (day/month/year)	Number		Country (or regional Office	e)	
25/05/2001 25 May 2001	00 0993	n	FRANCE		
Box No. VIII DECLAR			Titalion		
BOX NO. VIII DECEMIN					
The following declarations a the right column the number		/III (i) to (v) (mark the applica	ble check-boxes below and indica	te in Number of declarations	
Box No. VIII (i)	Declaration as to the ide	ntify of the inventor		:	
Box No. VIII (ii)	Dodustio- a- 4- 4-	dicante antidament 41 - 1	otomotional Elina data to! C	_	
Box No. VIII (II)	and be granted a patent	oncant's enduement, as at the I	nternational filing date, to apply fo	r :	
Boy Ma Vin (22)	Declaration of the the	licente antidoment de et de l	atomaticanal filina data to alais d	•	
Box No. VIII (iii)	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application :				
Box No. VIII (iv)	Declaration of inventors	hin (only for the number of the	e designation of the United States	of	
DOX 140. VIII (1V)	America)	imp (only for the purposes of the	ie designation of the Office States	:	
Box No. VIII (v)	Declaration as to non-no	eiudicial disclosures or excenti	ons to lack of novelty:	:	



Sheet No. 5

Box No. IX CHECK LIST; LANGUAGE ILING							
This international application contains: (a) the following number of sheets in	This international application is accompanied by the following item(s) (mark the applicable check-boxes below and indicate in right column the number of each item):						
paper form:							
request (including declaration sheets) : 4	1. fee calculation sheet						
description (excluding sequence listing part):	2. original separate power of attorney :						
7	3. original general power of attorney :						
claims : 3 abstract : 1	4. copy of general power of attorney; reference number, if any:						
drawings : 6	5. statement explaining lack of signature :						
Sub-total number of sheets : 21							
sequence listing part of description	6. priority document(s) identified in Box No. VI as item(s):						
(actual number of sheets if filed in paper form, whether or not also filed in computer readable form; see	7. translation of international application into (language):						
(b) below) :	8. separate indications concerning deposited						
Total number of sheets : 21	microorganism or other biological material :						
(b) sequence listing part of description filed in computer readable form	9. sequence listing in computer readable form (indicate also type and number of carriers						
(i) ☐ only (under Section 801(a)(i))	(diskette, CD-ROM, CD-R or other))						
(ii) in addition to being filed in paper form (under Section 801(a)(ii))	(i) copy submitted for the purposes of international search under Rule 13ter only (and not as part of the international application):						
Type and number of carriers (diskette, CD-ROM, CD-R or other) on which the sequence listing part is contained (additional copies to be indicated under item 9(ii), in right column):	(ii) (only where check-box (b)(i) or (b)(ii) is marked in left column) additional copies including, where applicable, the copy for the purposes of international search under Rule 13ter:						
	(iii) together with relevant statement as to the identity of the copy or copies with the sequence listing part mentioned in left column:						
	10. other (specify) Search Report :						
Figure of the drawings which	Language of filing of the						
should accompany the abstract: 3 Box No. X SIGNATURE OF APPLICANT, AC	international application: French GENT OR COMMON REPRESENTATIVE						
,	ning and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from readin						
Cabinet HECKE Cabinet HECKE Attorneys at Law of Patent Rights World Trade Center- Europole 5, Place Robert Schuman- B.P. 1537 38025 GRENOBLE Cedex 1- France Tel. 04 76 84 95 45 G. HECKE							
	For receiving Office use only						
Date of actual receipt of the purported international application: July 24, 2001	2. Drawings:						
 Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application: 	received:						
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):							
5. International Searching Authority (if two or more are competent): ISA /	6. Transmittal of search copy delayed until search fee is paid						
	or International Bureau use only						
Date of receipt of the record copy by the International Bureau:							

ŷ.



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou	mission du rapport de recherche internationale		
du mandataire PA 1283W0	(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après A DONNER		
Demande internationale n°	Date du dépôt international(jour/mois/année)	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année)	
PCT/FR 01/02411	24/07/2001	28/07/2000	
Déposant			
MESATRONIC			
Le présent rapport de recherche internati déposant conformément à l'article 18. Un	onale, établi par l'administration chargée de la re e copie en est transmise au Bureau internationa	echerche internationale, est transmis au al.	
Ce rapport de recherche internationale co	omprend3 feuilles.		
I	d'une copie de chaque document relatif à l'état d	de la technique qui y est cité.	
_			
1. Base du rapport			
	recherche internationale a été effectuée sur la b posée, sauf indication contraire donnée sous le		
la recherche internationa	e a été effectuée sur la base d'une traduction de	e la demande internationale remise à l'administration.	
	es de nucléotides ou d'acides aminés divulgu effectuée sur la base du listage des séguences	nées dans la demande internationale (le cas échéant)	
_	e internationale, sous forme écrite.	•	
déposée avec la demand	e internationale, sous forme déchiffrable par orc	linateur.	
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous forme écrite.		
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous forme déchiffrable par ordina	ateur.	
	ielle le listage des séquences présenté par écrit lemande telle que déposée, a été fournie.	et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la	
	uelle les informations enregistrées sous forme de présenté par écrit, a été fournie.	échiffrable par ordinateur sont identiques à celles	
2. Il a été estimé que certa	ines revendications ne pouvaient pas faire l'	objet d'une recherche (voir le cadre I).	
3. Il y a absence d'unité de	e l'invention (voir le cadre II).		
4. En ce qui concerne le titre,			
Ie texte est approuvé tel d	u'il a été remis par le déposant.		
Le texte a été établi par l'	administration et a la teneur suivante:		
F. Fa an animana and Baharini			
5. En ce qui concerne l'abrégé,	will a été romic par la dépassant		
<u>Ι</u> Δ.	qu'il a été remis par le déposant	rmémont à la ràgio 29 0h). La dépagant pout	
		ompter de la date d'expédition du présent rapport	
6. La figure des dessins à publier avec	l'abrégé est la Figure n°	3	
xuggérée par le déposant		Aucune des figures	
parce que le déposant n'a	a pas suggéré de figure.	n'est à publier.	
parce que cette figure car	actérise mieux l'invention.		

	· ·	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



Demande Internationale No

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G01R1/073

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G01R

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Α	EP 0 999 451 A (NITTO DENKO) 10 mai 2000 (2000-05-10) abrégé; figures 4,8A-9E	1,7
Α	WO 98 52218 A (HITACHI) 19 novembre 1998 (1998-11-19) abrégé; figures 7,8	7
A	WO 98 45716 A (MESATRONIC) 15 octobre 1998 (1998-10-15) cité dans la demande abrégé; figure 12	1
A	EP 0 772 049 A (NITTO DENKO) 7 mai 1997 (1997-05-07) colonne 4, ligne 11 -colonne 5, ligne 14 colonne 8, ligne 47 -colonne 9, ligne 28; figures 1A-2C	1
	-/	

Yoir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
A document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens *P* document publié avant la date de dépôt international, mais	 'T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention 'X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément 'Y' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier &' document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 19 décembre 2001	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 28/12/2001
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé Iwansson, K

1



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



Demande Internationale No
PR 01/02411

	la de la companya de			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information patent family members

International Application No
POR 01/02411

Patent document cited in search report		Publication date	•	Patent family member(s)		Publication date
EP 999451	A	10-05-2000	JP EP TW	2000150594 0999451 439166	A2	30-05-2000 10-05-2000 07-06-2001
WO 9852218	Α	19-11-1998	JP WO US	11023615 9852218 6305230	A1	29-01-1999 19-11-1998 23-10-2001
WO 9845716	A	15-10-1998	FR AT CN DE EP WO US	20.000	T T D1 A1 A1	16-10-1998 15-09-2001 03-05-2000 27-09-2001 02-02-2000 15-10-1998 18-09-2001
EP 772049	Α	07-05-1997	JP JP EP US	3096234 9127157 0772049 5848465	A A2	10-10-2000 16-05-1997 07-05-1997 15-12-1998

		·	
	*		